# ホウ化物系セラミックスの焼結特性に及ぼす 脱ガス処理の影響

高橋志郎,田谷嘉浩,菅原智明,下野 功, 小林孝紀,加賀 壽

# Effect of De-gassing on Sintering Characteristics in Boride Type Ceramics

Shiro Takahashi, Yoshihiro Taya, Tomoaki Sugawara, Isao Shimono, Takanori Kobayashi and Hisashi Kaga

# 

要

ホウ化物系セラミックス材料は,優れた高温強度,耐摩耗性を有し,比強度が高いことから高温での耐 摩耗材料として期待されている。本研究では,原料となる各要素粉末をミクロ的に均一混合した粉体を用 いた放電プラズマ焼結機(SPS)によるホウ化物系セラミックス焼結体の緻密化について,昇温脱離ガス の除去という観点から検討した。W,Cr,Ti及び Bの各要素粉末を混合して用いたホウ化物系セラミック ス焼結体の作製では,焼結中に多量のCOガス及びH2ガスが発生し,焼結体中に気孔として残ることで密度 の低下につながった。加圧のタイミングを脱離ガス発生温度以上,かつ,ホウ化物形成温度以下で行う脱 ガス処理を施すことで,極めて効果的な緻密化が進行することが分かった。

#### 1. はじめに

近年、機械・装置技術が急速に発達し、より高 温あるいは高負荷での使用に耐えられる材料の開 発が産業界から求められている。特に、高温にお ける優れた耐摩耗性を有する材料の開発は、早急 の課題といえる。このような要求を満たす材料と しては、 高融点金属材料やセラミックス材料, 最 近では金属間化合物材料が多く用いられている。 中でも、Ti (チタン) – B (ホウ素) 系の化合物 であるTiB<sub>2</sub> (チタンダイボライド) 焼結材料は, 高温における低熱膨張率、優れた高温強度、高い 耐摩耗性を有し、さらに比強度が高いことから高 温での耐摩耗材料として期待されている<sup>1)</sup>。また, TiB,は、多くの金属材料と同様に、他のセラミッ クス材料に比べて導電性に極めて優れていること から,放電加工が可能であり,高い加工性を有す る。しかし、現状では、TiB2は焼結性に劣ること から, 良好な機械的性質を有する焼結体は得られ ていない。これは、TiB<sub>2</sub>の製造に幾つかの問題点 が指摘されている<sup>1)-3)</sup>ことに起因するものと考 えられる。

以前の報告<sup>4)</sup>で、(Ti, W, Cr)B<sub>2</sub>焼結体を、(Ti, W, Cr) + 2B → (Ti, W, Cr)B<sub>2</sub>の自己発熱反応熱を有 効に利用できる要素粉末を用いた焼結が、SPS法 によって可能となったことを示した。しかし、各 要素粉末を用いた焼結では、昇温中に何らかの特 異挙動が起こり、多量のガスが発生することが分 かった。このガスは、焼結体中に気泡(気孔)と なって残存し、密度を低下させるだけでなく、き 裂発生サイトになるなど機械的性質を著しく低下 させる。

本研究では、(Ti, W, Cr)B<sub>2</sub>について各要素粉末 を用いた反応焼結を行い、ホウ化物セラミックス 焼結体の緻密化を昇温脱離ガス除去という観点か ら検討し、反応焼結材料の製造に必要な基盤的要 素技術を開発することを目的とした。

### 2. 供試材及び実験方法

供試材には,原料粉末として粒子径 -325メッ シュ,純度99.9%のTi,粒子径5 $\mu$ m,純度99.99 %のW,粒子径5 $\mu$ m,純度99.7%のCr及び粒子 径-325メッシュ,純度99%のBの各粉末を用いた。 これらの原料粉末を,TiB<sub>2</sub>,WB<sub>2</sub>,CrB<sub>2</sub>のみ が生成すると仮定した表1の組成になるように配 合した。所定の組成比に配合した混合粉末を,直 径10mmのメノーボールとともに容積250ccのメノー ポットに挿入し,アルゴン雰囲気中で遊星ボール ミルにて30時間混合を行った。この混合粉末をMA 30のように表記する。

表1 供試材の化学組成(mol%)

Ti	W	Cr	В
0. 54	0. 36	0. 10	2.00

MA30混合粉末25g(相対密度100%で10mmの焼結 体が得られる)を内径20mmの黒鉛型に挿入し,SP S装置を用いて、1.5Paまで真空排気後、焼結温 度1700℃,昇温速度100℃/分,加圧応力50MPaに て焼結を行った。脱ガス処理である加圧開始のタ イミングは、焼結中の温度が室温、600℃,700℃, 750℃,800℃,850℃,1000℃及び1700℃とした。 この加熱サイクルを図1に示す。焼結温度の測定 は、1000℃以下では熱電対を、それより高い温度 では放射温度計を用いた。





焼結体の密度測定は、アルキメデス法により行っ た。また、SPS焼結中の昇温脱離ガスの分析は、 キャピラリー及びオリフィスを用いたガス分析シ ステムを構築して行った。ガス分析装置には四重 極型質量分析装置(QMS)を用い、SPSチャンバー 内の雰囲気圧に応じた昇温脱離ガスを連続的に取 り込み分析した。本実験における昇温脱離ガスの 分析項目は、ピークが検出された $H_2$ ,  $H_20$ ,  $CH_4$ ,  $CO及びCO_2$ とした。測定したデータは、SPSチャン バー内の雰囲気圧、ガス分析装置の分析管内の雰 囲気圧及び各分析項目ガスの分圧で表記した。

## 3. 結果及び考察

3.1 焼結条件の検討

脱ガス処理による焼結体の緻密化を行うにあたっ て適切な焼結条件を決定するために(1)焼結温度 の選択(2)脱ガス処理温度の検討を行った。

本実験では、反応焼結を行うため、反応が完結 し構成相が安定していないと焼結体の緻密化を評 価することは困難である。すなわち、焼結中に十 分な反応が得られていないと、相変態や追加反応 が起こり密度変化をきたす。このような密度の変 化を防ぐために、予備試験として、900℃~1700 ℃で焼結を行い、焼結体構成相の変化をXRDにて 観察した。その結果を図2に示す。これより、12 00℃以上の焼結体と1100℃以下の焼結体では、XR Dパターンに極めて大きな相違があることが分かっ た。1200℃以上の焼結体では、Ti, W, Cr など 原料粉末のピークは認められず、そのほとんどが TiB<sub>2</sub>及びWBのみのピークとなっている。一方、

1100℃以下の焼結体では、原料粉末のXRDパター ンと同様に Ti, W, Crのピークが認められる。 1100℃以下の焼結体の場合にも、一部にWBのピー クが認められるが、そのピーク強度は、1200℃ 以上の焼結体よりも小さい。1100℃ 以下の温度 で焼結を行った場合には、WB以外の化合物相を形 成せず, 依然として要素粉末が単一金属相の形で 検出されている。一方,1200℃以上の温度で焼結 を行った場合は、目的の化合物相である TiB<sub>2</sub> が 生成される。また、1700℃の焼結体では、WBが減 少し、WB2の析出量が増加している。本合金系は, 金属原子がB原子と1:2の割合で化合するような配 合となっているため, WB₂のより多い1700℃でよ り反応が進行していると考えられる。焼結温度を 1900℃まで上昇した場合でも、依然としてわずか ながらWBの析出が認められた。本研究では、焼結 コストの低減も考慮した1700℃を焼結温度とした。 次に,脱ガス処理温度の検討を行った。図3に, 昇温に伴うSPSチャンバー内のガス圧変化を示す。 昇温脱離ガスは、100℃、500℃、850℃近傍に放 出のピークが存在する。各放出ガスの分析を行っ たところ100°C及び500°C近傍のピークはH<sub>2</sub>0であ ることが分かった。これより,脱ガス処理温度を 室温(脱ガス処理なし),600°C,850°C,1000°C, 1700°Cとしたところ,600°C~850°Cで大きく密度 が変化したことが分かった。そこで,700°C,750 °C,800°Cの3点を追加して脱ガス処理温度とし た。

#### 3.2 ガス昇温脱離挙動の解析

焼結中に放出される昇温脱離ガス全体の挙動は, 図4のとおりであった。分析装置の雰囲気圧(全



図2 MA30における焼結温度の変化に伴う構成相の変化



図3 SPS焼結中のチャンバー内圧力の変化

圧)の変化は、若干の時間的な遅れはあるものの、 概ねSPSチャンバー内の全圧の変化と一致した挙 動となっている。放出される昇温脱離ガス中で最 も放出量の多いガスはH₂0であり、500℃以下では 放出ガスの95%以上をH20が占めていることが確認 された。また、特定の温度でCO及びH<sub>2</sub>ガスの放出 量が増加していた。図5に、特異的なガス放出の あったCO及びH<sub>2</sub>ガスの分圧を示す。MA30粉末の焼 結における昇温脱離ガス量は、各要素粉末のみを 用いた焼結の場合に比べて多くなっている。また、 COガスは要素粉末のみの場合にはあまり放出され なかったが、MA30粉末では焼結温度800℃前後で 多量に放出されている。H,は、約600℃近傍で顕 著に放出量が増加している。Cr及びBのみを焼結 した場合にもH<sub>2</sub>の放出は認められたが、この温度 での放出は認められず、その放出量も極めて少な い(図5)。このように、各要素粉末と混合粉末 の焼結中におけるガスの昇温脱離挙動の違いは, 焼結中に起こる化合反応に起因するものと思われ るが十分な解析には至っていない。なお、ガス分 析結果の再現性は非常に良好で、いずれの粉末に おいても測定データの再現性は高く、よく一致し た。

#### 3.3 脱ガス処理による緻密化の検討

焼結中には、温度上昇に伴い、粉末からガスが 放出されることがガス分析の結果からも分かる。 その総量は、1気圧で1000mm<sup>3</sup>(1CC)以上にもな り、これらがすべて焼結体中に残り気孔を形成す



図4 MA30粉末焼結中のガス分析結果



# 図 5 SPS焼結中におけるCOおよびH<sub>2</sub>ガスの 昇温脱離挙動

ると相対密度は75%にまで減少する。SPS法は, その特性上,加熱に際して最低約5kNもの圧力を 加えなければならない。加圧することで放出され た脱離ガスの排出経路が狭まり、気孔を造りやす い。さらに、緻密化にはより大きな圧力が必要と なるため効率の良い脱ガス処理が望まれる。図6 に, 脱ガス処理温度と焼結体の相対密度との関係 を示す。脱ガス処理(加圧開始)温度が高いほど 焼結体の緻密化が進む傾向となった。室温から加 圧を開始した焼結体では約91.6%、緻密化がほぼ 飽和した850℃以上では約96.3%の相対密度が得 られた。脱ガス温度600℃~750℃では、相対密度 が低く、脱ガスが不十分であった。これは、加圧 開始後,放出されるCOガスが密封された状態とな り、焼結体中に気孔として存在するためと考えら れる。現在、気孔の検出について検討中である。 脱ガス温度1700℃焼結体の相対密度は不安定で, 850℃~1000℃焼結体よりも相対密度が低い。こ れは、約1500℃になると反応合成が著しく進行す るが、加圧力を加えていない状態であることから 粉末同十の密着が少なく近接した小さな領域での みホウ化物を形成したためと考えられる。要素粉 末ではなくホウ化物を焼結しようとする場合、自 己発熱を利用できないだけでなく、極めて高い温 度での焼結が必要となる。一般のIIP法による焼結 では、約2000℃の高温で焼結することからも、一 度形成したホウ化物の緻密化が困難であることが



図6 脱ガス処理温度による相対密度の変化

示唆される。このため、1700℃で脱ガス処理を行った焼結体の密度が低くなったと考えられる。

以上のように,放出されたガスを焼結体中にと どめることなく排出することが,緻密化の上で最 も重要であり,機械的性質の向上を目指す上で脱 ガス処理の確立は急務であるといえる。本研究で は,加圧開始温度を制御したのみで緻密化が行わ れたことから,今後の課題として,積極的な脱ガ ス処理工程の確立を行う予定である。

#### 4. まとめ

 (1), W, Cr, Ti及び B各要素粉末を用いた焼結を 行うことでCOガス及びH<sub>2</sub>ガスなどの昇温脱離ガス が多量に放出される。

(2)昇温脱離ガスが焼結体中に残留することで密 度低下を引き起こす。

(3)加圧開始温度を制御することで効果的に緻密 化が可能となる。ただし、この方法のみでは相対 密度は96%程度で、今後は積極的な脱ガスプロセ スの開発が急務である。

### 参考文献

- 加賀 寿, E. M. Carrillo-Heian, Z. A. Munir:粉体及び粉末冶金,第47巻,第8号 (2000), P909-915
- 2) D-G. Ahn, A. Kawasaki and R. Watanabe: Material Trans. JIM., 第37号 (1996), P1

078-1083

- 3) I. Mitra and R. Telle: J. of Solid State Chemistry, 第133号 (1997), P25-30
- 4)高橋 志郎,田谷 嘉浩,菅原 智明,下野
  功,小林 孝紀,加賀 壽:北海道立工業
  技術センター 研究報告,第7号(2002), P26-30